

第 107 回マイクロ接合研究委員会

プログラム

日 時：平成 26 年 7 月 4 日(金) 10:30～16:35

場 所：(株)島津製作所 関西支社 マルチホール(大阪 梅田)

	時 間	題 目	講 演 者
平成 26 年 7 月 4 日 (金)		司 会 中島 泰 (三菱電機(株))	
	10:30～11:15	Mate2014 受賞講演 『Sb 粉末を添加した Sn-3Ag-0.5Cu はんだの 接合信頼性』	大阪大学 ○福田 敦
	11:15～12:00	Mate2014 受賞講演 『共晶反応と表面微細形状を利用したアルミニウムダイレ クト接合の基礎的検討(共晶反応と表面微細形状を利用し た Pb フリーSiC 高温実装技術(第一報))』	大阪大学 ○小椋 智
	12:00～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:10	委 員 会 議 事	
		司 会 福本信次 (大阪大学)	
	13:10～13:55	Mate2014 受賞講演 『パターンめっきにおける Au-Sn 合金の 酸化メカニズムの解明』	(株)東芝 生産技術センター ○中山俊弥、浮田康成、樋口和人 (株)東芝 セミコンダクター&ストレージ社 細美英一、村川 篤
	13:55～14:40	『溶接困難材料の微細レーザ溶接』	岡山大学 ○岡本康寛
	14:40～15:00	休 憩	
		司 会 岩田剛治 (大阪大学)	
	15:00～15:35	『電気アシスト接合法による Al/Cu および Al/A5052 の固相接合』	群馬大学 ○富川陽平、小山真司
	15:35～16:20	『原子拡散接合法による室温接合技術』	東北大学 ○島津武仁、魚本 幸、今 一恵
	16:20～16:35	MJ 賞 表彰式	

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。